

NUMBER 178305

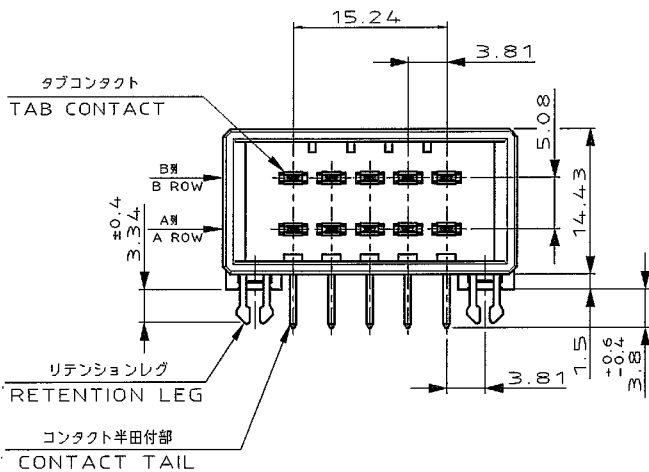
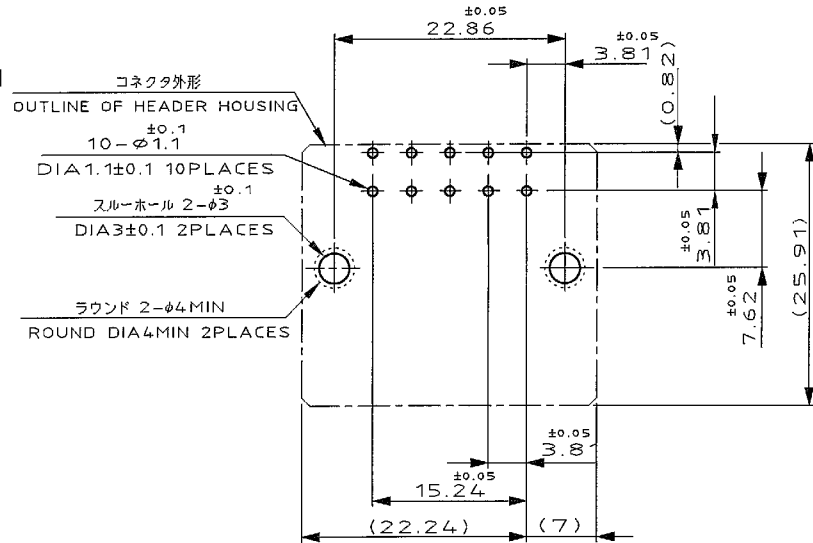
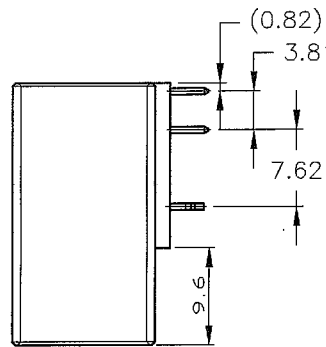
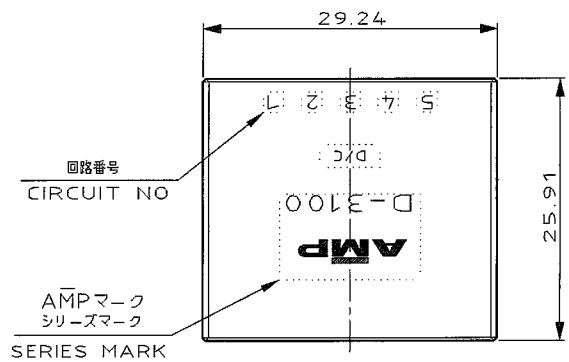


METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83



推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の下に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の下にスズめっき

△6	△4	178305-5
△6	△3	178305-3
△6	△2	178305-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

REV	REVISION	DATE	BY	CHK	DATE
C	REVISED (FJD0-0039-03)	T.S.M.	4/15/93		
B	REVISED (FJD0-0097-03)	T.S.M.	3-23/93		
A	REVISED (FJ00-2183-95)	KI	3-4/95		
O	RELEASED (J-1184)	NM	3-4/92		
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	

Copyright © 1991 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE mm(TAWG -)		INSULATION DIA mmφ	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照	
NAME ダイナミック D3100 水平タイプ 10 番 ヘッダーアセンブリ 10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100			
(GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC NUMBER
A3		J	C-178305
SCALE		REV.	SHEET
2-1		C	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面